



Brightening the Future
Since 1946

2023年度(2024年3月期) 第1四半期決算概要について

新光電気工業株式会社



目次

2023年度 第1四半期決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

2023年度 上期・通期の見通し（連結）

売上高・損益・配当	11
-----------	----

2023年度 設備投資額・減価償却費・研究開発費

千曲工場の供給確保計画の認定について（6/16付リリース）

2023年度 第1四半期決算概要（連結）

決算概況

（単位：億円）

	2022年度 1 Q	2023年度 1 Q	前年同期比	
				増減率
売上高	794	492	△302	△38%
営業利益 （営業利益率）	260 (33%)	37 (8%)	△223	△86%
経常利益 （経常利益率）	282 (36%)	56 (11%)	△226	△80%
純利益※ （純利益率※）	195 (25%)	37 (7%)	△159	△81%

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益	144.71円	27.04円
-------------	---------	--------

2023年度 第1四半期決算概要（連結）

概況

- 半導体業界は、世界的なインフレの継続や米中対立の影響に加え、コロナ特需の反動によるパソコン、サーバー市場の落ち込みや、買い替えサイクル長期化等によるスマートフォン需要の減少、在庫調整などにより、厳しい市場環境が継続。
- 当社グループにおいては、フリップチップタイプパッケージは、パソコンやサーバー向けの需要減退が継続したことなどにより売上が大きく減少。リードフレームは在庫調整の影響を受け、半導体製造装置向けセラミック静電チャックは半導体輸出規制に加え、市況悪化を背景に減収。IC組立についてもハイエンドスマートフォン向けの需要が減少するなど、総じて市況低迷の影響を受けた。
- 前年同期比で売上高38%減、売上高減少の影響を大きく受け、各利益とも減少。

2023年度 第1四半期決算概要（連結）

セグメント別売上高・経常利益

（単位：億円）

セグメント		2022年度 1Q		2023年度 1Q		前年同期比 増減率 (%)	2022年度	
			構成比(%)		構成比(%)			構成比(%)
売上高 ※1	プラスチックパッケージ	495	(62)	299	(61)	△40	1,768	(62)
	メタルパッケージ	273	(35)	172	(35)	△37	993	(35)
	その他	26	(3)	21	(4)	△18	102	(3)
	合計	794	(100)	492	(100)	△38	2,864	(100)
経常利益 ※2	プラスチックパッケージ	193	(39)	26	(9)	△87	473	(27)
	メタルパッケージ	98	(36)	45	(26)	△54	312	(31)
	その他/調整額	△9		△15			2	
	合計	282	(36)	56	(11)	△80	788	(28)

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

2023年度 第1四半期決算概要（連結）

財政状態、設備投資・減価償却費等

（単位：億円）

	2022年度 1 Q	2023年度 1 Q
総資産	3,374	3,858
純資産	2,190	2,519
自己資本比率	65%	65%

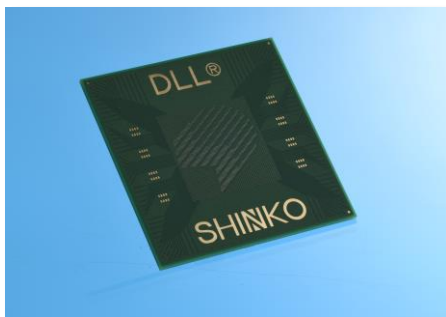
2022年度
3,869
2,510
65%

設備投資額 ※	85	165
減価償却費 ※	78	62
研究開発費	9	8
為替レート(1米ドル)	128円	136円

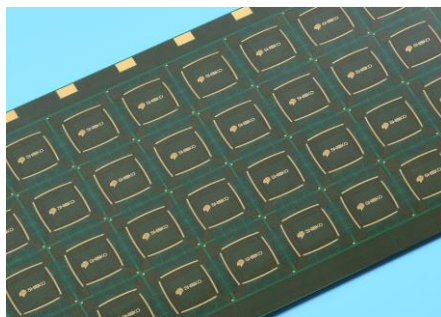
258
345
36
134円

※ 無形固定資産を除く

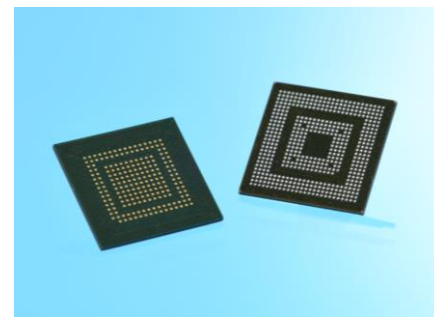
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

2023年度 第1四半期決算概要（連結）

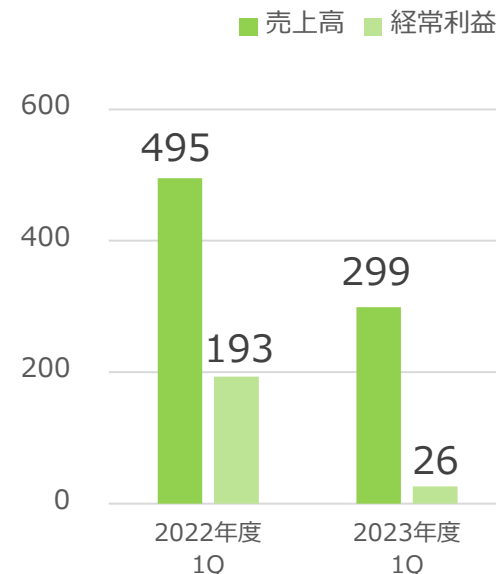
プラスチックパッケージ

（単位：億円）

	2022年度 1 Q	2023年度 1 Q	前年同期比	
				増減率
売上高（構成比）	495（62%）	299（61%）	△196	△40%
経常利益（経常利益率）	193（39%）	26（9%）	△167	△87%

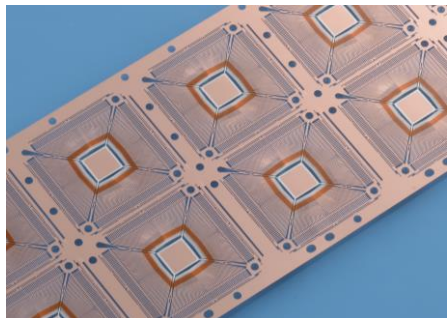
各製品の売上減少により、前年同期比で減収減益

- フリップチップタイプパッケージは、コロナ特需の反動などによるパソコンやサーバーの需要減退等により、大幅な減収
- IC組立は、スマートフォン市場の低迷によりハイエンドスマートフォン向けの需要が減少し、売上が減少
- プラスチックBGA基板は、先端メモリー向けが在庫調整の影響を受け売上が減少

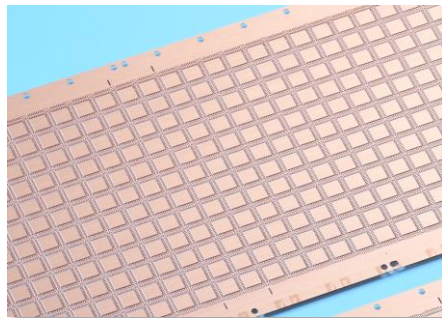


2023年度 第1四半期決算概要（連結）

メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

2023年度 第1四半期決算概要（連結）

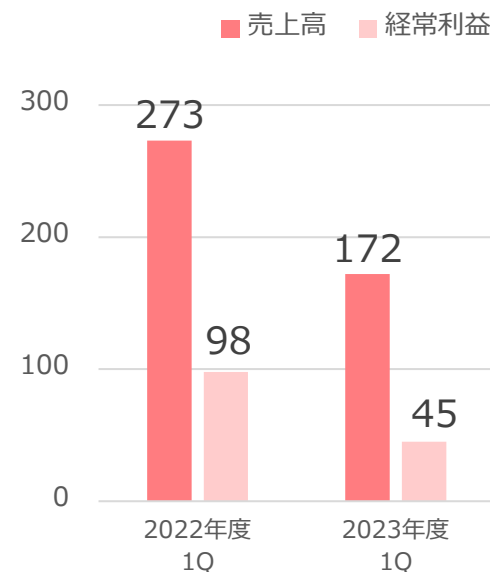
メタルパッケージ

（単位：億円）

	2022年度 1 Q	2023年度 1 Q	前年同期比	
				増減率
売上高（構成比）	273（34%）	172（35%）	△101	△37%
経常利益（経常利益率）	98（36%）	45（26%）	△53	△54%

各製品の売上減少により、前年同期比で減収減益

- リードフレームは、半導体市況低迷による在庫調整等の影響を大きく受け大幅な減収
- セラミック静電チャックは、米中对立による半導体輸出規制の影響やメモリー市況悪化などを背景として、大幅な減収
- CPU向けヒートスプレッダーは、パソコン需要減退等の影響を受け売上が減少
- ガラス端子は、光学機器向けが低調に推移し減収



2023年度 第1四半期決算概要（連結）

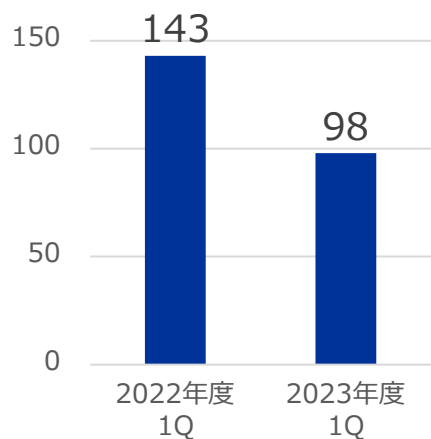
部門別売上高

（単位：億円）

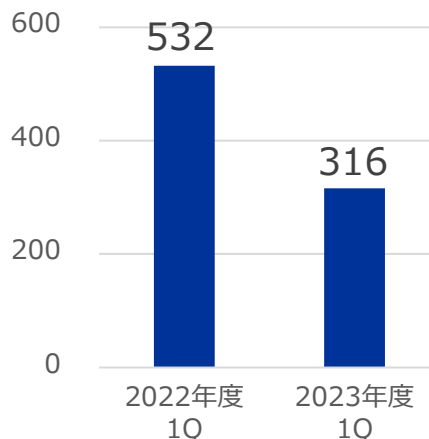
	2022年度 1 Q	2023年度 1 Q	前年同期比		2022年度
				増減率	
I C リードフレーム	143 (18%)	98 (20%)	△46	△32%	497(17%)
I C パッケージ	532 (67%)	316 (64%)	△216	△41%	1,879 (66%)
気 密 部 品	118 (15%)	79 (16%)	△40	△34%	487 (17%)

※（ ）は構成比

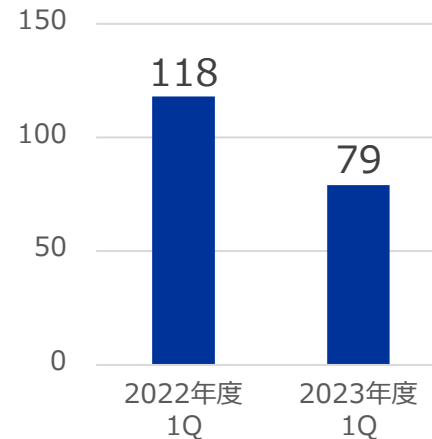
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



2023年度 上期・通期の見通し（連結）

売上高・損益・配当

（単位：億円）

	2022年度（実績）			2023年度（予想）			前年同期比（上段：増減金額、下段：増減比率）		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
売上高	1,570	1,294	2,864	1,120	1,490	2,610	△450 (△29%)	196 (15%)	△254 (△9%)
営業利益 (営業利益率)	510 (32%)	258 (20%)	767 (27%)	80 (7%)	270 (18%)	350 (13%)	△430 (△84%)	12 (5%)	△417 (△54%)
経常利益 (経常利益率)	546 (35%)	241 (19%)	788 (28%)	80 (7%)	270 (18%)	350 (13%)	△466 (△85%)	29 (12%)	△438 (△56%)
純利益※1 (純利益率※1)	379 (24%)	166 (13%)	545 (19%)	60 (5%)	180 (12%)	240 (9%)	△319 (△84%)	14 (8%)	△305 (△56%)
為替レート	134円/\$			136 円/\$※2	120円/\$ (2~4Q想定)				

※1 親会社株主に帰属する当期純利益

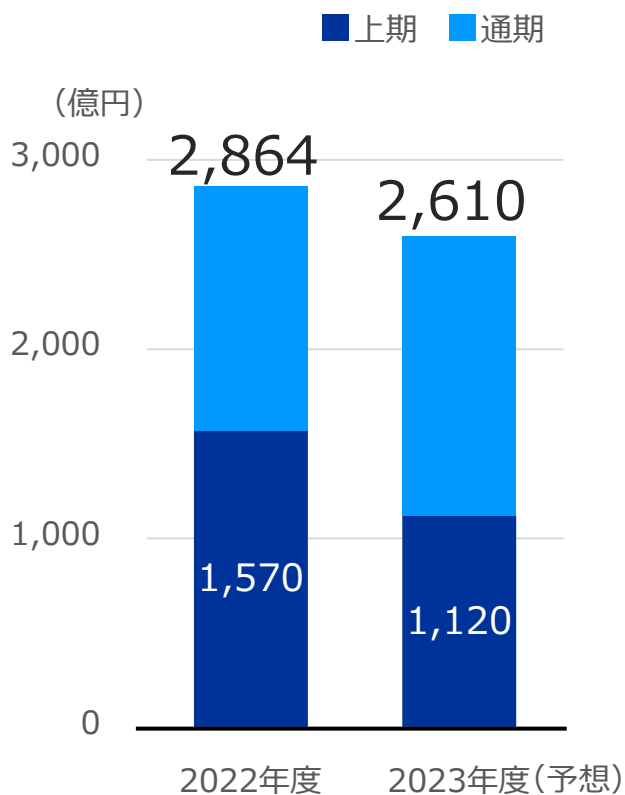
※2 2023年度1Q実績

（単位：円）

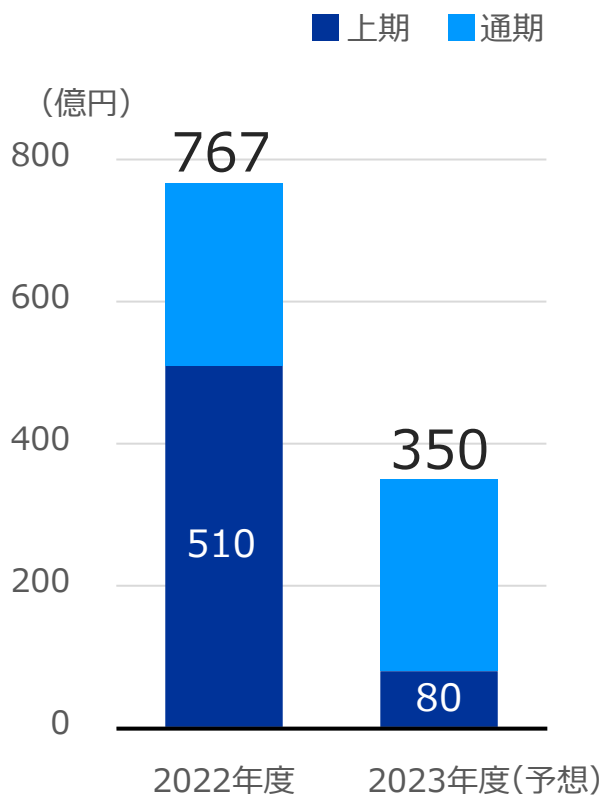
1株当たり配当金 (配当性向)	25.0 [中間]	25.0 [期末]	50.0 (12.4%)	25.0 [中間]	25.0 [期末]	50.0 (28.1%)
--------------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

2023年度 上期・通期の見通し（連結）

売上高

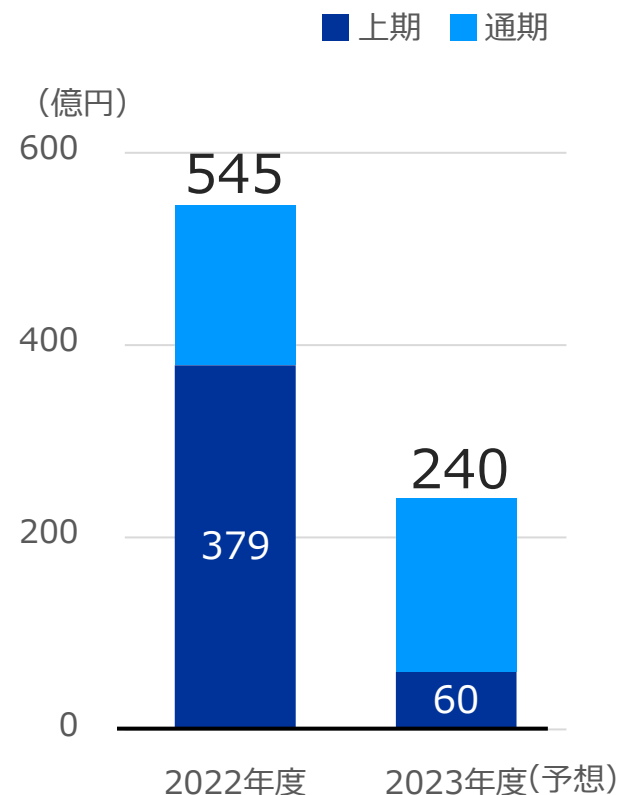


営業利益



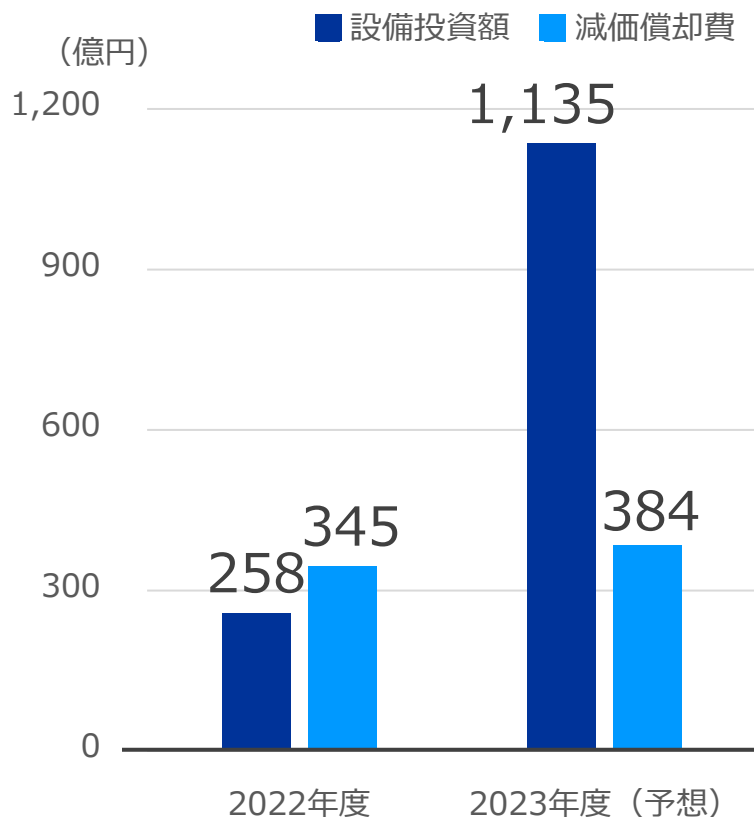
純利益※

※親会社株主に帰属する当期純利益

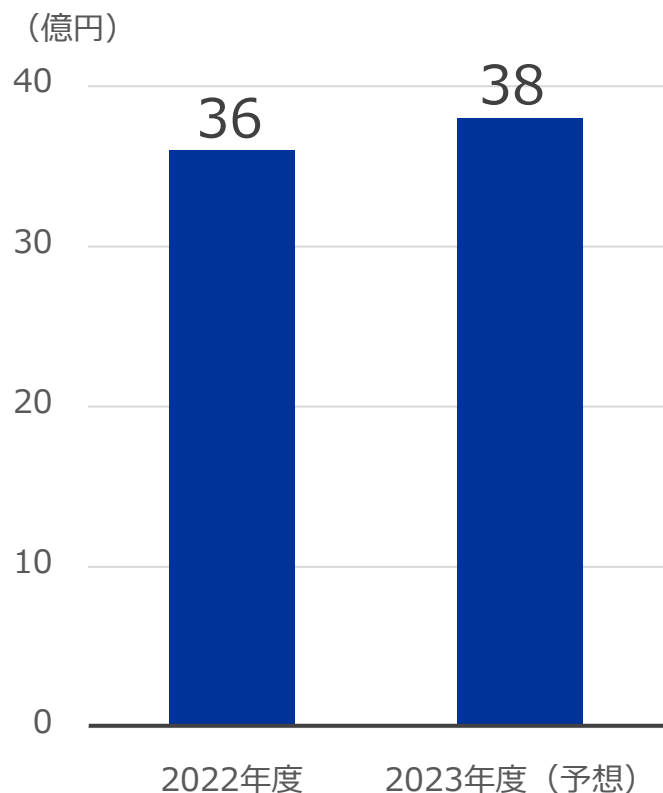


2023年度 設備投資額・減価償却費・研究開発費

設備投資額・減価償却費



研究開発費



千曲工場の供給確保計画の認定について

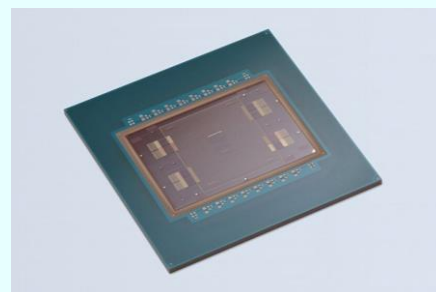
2023年6月16日付リリース（要旨）

千曲工場（長野県千曲市）における先端半導体向け次世代フリップチップタイプパッケージ（FC-BGA基板）の設備投資計画が、経済産業大臣により、経済安全保障推進法に基づく「供給確保計画」に認定されました。これにより、千曲工場における設備投資計画に助成金が交付される予定です。

今後も半導体の需要は中長期的に拡大することが見込まれ、特にサーバー向け等に使用される先端半導体の市場が大きく拡大し、半導体の高機能化、高速化と省電力化に加え、大型化、高多層化、高密度微細配線等に対応する、さらに進化したFC-BGA基板の需要が飛躍的に高まることが想定されます。当社はこのようなニーズを捉え、「i-THOP®」等の次世代FC-BGA基板の開発を行っており、その量産体制を千曲工場に構築することにより、半導体関連産業の発展やGXの実現等、より豊かな社会づくりに貢献してまいります。

【供給確保計画の概要（予定）】

- (1) 事業者の名称 : 新光電気工業株式会社
- (2) 投資額 : 533億円
- (3) 最大助成額 : 178億円
- (4) 施設 : 千曲工場
- (5) 主要生産製品 : 次世代FC-BGA基板



i-THOP®

i-THOPは新光電気工業(株)の登録商標です。

※本リリースの詳細は2023年6月16日発表の「千曲工場の供給確保計画の認定について」をご覧ください。
https://www.shinko.co.jp/news/docs/20230616_01.pdf

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。